

102年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師、
社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、
102年專門職業及技術人員特種考試語言治療師考試試題

代號：3113
頁次：6-1

等 別：相當專技高考

類 科：牙體技術師

科 目：牙體技術學(三) (包括全口活動義齒技術學、活動局部義齒技術學科目)

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 與全口義齒磨光面有接觸的口腔組織為：①殘嵴粘膜 ②硬腭 ③唇 ④頰 ⑤舌背 ⑥舌根 ⑦軟腭
(A)①④⑥⑦ (B)②③④⑦ (C)①③④⑤ (D)③④⑤⑥
- 2 由頭部的側面看，下顎咬合面前後呈現出之曲線稱為何者？
(A)威爾生氏曲線 (Wilson's curve) (B)史比氏曲線 (Spee's curve)
(C)甘伯氏線 (Camper's line) (D)史魯氏曲線 (Snow's curve)
- 3 全口義齒最常用之前後咬合參考平面為何者？
(A)瞳孔間連線 (interpupillary line) (B)甘伯氏平面 (Camper's plane)
(C)彭維爾三角 (Bonwill triangle) (D)法蘭克福平面 (Frankfort plane)
- 4 要減少全口義齒的門齒導引角時，下列方法何者正確？
(A)增加水平覆蓋 (B)增加垂直覆蓋
(C)水平覆蓋及垂直覆蓋皆減少 (D)水平覆蓋及垂直覆蓋皆增加
- 5 全口義齒之支持區域，上顎與下顎之比例大約為多少？
(A)上顎 1 對下顎 1 (B)上顎 2 對下顎 1 (C)上顎 3 對下顎 1 (D)上顎 4 對下顎 1
- 6 全口義齒邊緣成型 (border molding) 之目的為何？
(A)得到邊緣密封 (B)得到恰當之支持力
(C)獲得組織面之機能塑型 (D)獲得緩壓
- 7 有關個人牙托之敘述，下列何者正確？
(A)由常備模托中選出適合各個人牙弓之牙托
(B)將金屬模托修整成適合各個人牙弓之牙托
(C)在研究用模型上另行製作適合各個人牙弓之牙托
(D)將選出之牙托，當作個人專用之牙托
- 8 個人牙托之邊緣製作時，須注意下列何者？
(A)除上顎之腭後緣為防止敏感須更短些外，其他地方都只要比基底外形線短 2~3 毫米
(B)下顎的臼齒後墊部位及上顎腭後緣部位須長些，其他地方都只要比基底外形線短 2~3 毫米
(C)全部邊緣都只要比基底外形線短 2~3 毫米
(D)下顎的臼齒後墊部位及上顎腭後緣部位須更短些，其他地方則要比基底外形線短 2~3 毫米
- 9 製作個人牙托時，使用間隙劑 (spacer) 之主要目的為何？
(A)提供緩壓 (B)防止口水入侵 (C)防止印模材收縮 (D)提供印模材空間
- 10 下列那些部位在全口義齒取模時須緩壓？①頰孔 ②門齒孔 ③頰棚 ④腭隆凸 ⑤下顎齒槽骨嵴
(A)①②④⑤ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)①②③④
- 11 全口義齒以二階段法熱煮聚操作時，第一階段使用的溫度為何？
(A)攝氏 45~50 度 (B)攝氏 55~60 度 (C)攝氏 65~70 度 (D)攝氏 75~80 度

- 12 圍盒 (boxing) 之目的為何？①保護取模之邊緣部完整 ②確保工作模型使用之厚度 ③防止石膏溢流 ④節省材料與操作時間
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 13 全口義齒工作模型使用之超硬石膏，其混水比例 (w/p ratio) 比其他石膏低，理由為何？
(A)結晶形狀不同 (B)結晶水較多 (C)結晶顏色不同 (D)含水量較低
- 14 下顎全口義齒在人工牙齒排列時的最後方位置為何？
(A)臼齒後墊高度 1/2 處 (B)臼齒後墊前緣
(C)臼齒後墊後緣 (D)臼齒後墊最上緣
- 15 面弓轉移之目的為何？
(A)將上下顎模型固定於咬合器上之固定位置
(B)將上下顎模型依各人垂直高度之不同，固定於咬合器
(C)將上下顎模型依各人上顎與髁關節之關係位置，固定於咬合器
(D)將上下顎模型依各人之咬合關係，固定於咬合器
- 16 下列有關全口義齒後障 (postdam) 之敘述，何者正確？
(A)目的是圍盒時，防止後緣石膏溢流之封閉 (B)位於臼齒後墊處
(C)位於上下顎義齒邊緣最後延伸處 (D)為提供腭後緣封鎖之目的而做
- 17 有關全口義齒基底板製作之敘述，下列何者正確？①須使用可耐咬合壓強度之材料 ②邊緣須短 2~3mm，以防影響咬合記錄 ③須預留排牙空間 ④須不受口腔溫度影響變形 ⑤多使用常溫聚合樹脂
(A)①④⑤ (B)②④⑤ (C)①③⑤ (D)②③④
- 18 面弓轉移時最常使用之基準面為下列何者？
(A)左右鼻翼耳珠線 (naso-tragus line) (B)左右甘伯氏線 (Camper's line)
(C)鼻根蝶鞍面 (SN plane) (D)法蘭克福平面 (Frankfort plane)
- 19 下列關於將全口義齒下顎工作模型在咬合器上固定之敘述，何者正確？①須先確立正確之顎間關係 ②須使用裂模法 ③須利用面弓轉移 ④須先建立正確之髁導引度數
(A)① (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 20 下列有關門齒導引記錄之敘述，何者正確？①須待門齒在患者口中試戴後進行 ②由前齒部之水平覆蓋及垂直覆蓋決定 ③須記錄工作側之前齒路徑 ④須記錄平衡側之前齒路徑
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 21 有關全口義齒製作時，髁傾斜角度記錄之敘述，下列何者正確？
(A)必須使用髁關節型 (arcon) 咬合器記錄 (B)咬合器之髁頭傾斜角須先設定在 30 度或 40 度
(C)記錄前須設定門齒導引之角度 (D)可使用髁頭在前突運動時之軌跡去記錄
- 22 經面弓轉移且已在咬合器固定之工作模型，如發現咬合位置有誤，再另取一正確之新咬合記錄後，下列處置何者適宜？
(A)拆下上顎模型，依新咬合記錄重新固定
(B)拆下下顎模型，依新咬合記錄重新固定
(C)拆上顎或下顎模型皆可，但須使用裂模法
(D)須先固定好新的咬合記錄後，始可拆下上顎之裂模模型
- 23 下列有關人工牙齒之敘述，何者正確？①陶齒基部有金屬釘與義齒基底結合良好，但材質較硬 ②樹脂齒材質較軟，故較易由義齒基底斷裂脫落 ③陶齒雖較硬，但牙床受衝擊力較大 ④樹脂齒較可緩壓，但易磨耗
(A)①④ (B)①② (C)②③ (D)③④
- 24 在正常咬合狀態下，工作側是指下列何者？
(A)在中心咬合位時，咀嚼側之位置
(B)咀嚼時，以門牙咬切食物時之位置
(C)下顎向右側時，左側也應咬到，兩側皆為工作側
(D)下顎行側方運動時，向右時工作側在右側，向左時即在左側

- 25 全口義齒之平衡咬合行側方運動時，上下顎應接觸之牙齒為：①工作側後牙 ②平衡側後牙 ③工作側門牙 ④平衡側門牙
(A)①②③ (B)③④ (C)①④ (D)①③④
- 26 下列有關全口義齒人工牙齒排平衡咬合時之敘述，何者正確？
(A)後牙必須按照補償曲線排列 (B)人工牙齒都必須稍作選擇修磨，才可能達成
(C)選擇零度人工牙齒，較易達成 (D)髁導引須大於門齒導引
- 27 全口義齒人工牙齒排為平面咬合（**monoplane occlusion**）時，下列敘述何者正確？①要使用零度人工牙 ②可減少牙嵴之側方受力 ③咀嚼壓力可減輕 ④無法達到平衡咬合
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- 28 全口義齒煮聚完成後，在技工室再裝載（**remount**）以修整咬合時，下列敘述何者正確？
(A)必須事先以裂模法裝回咬合器原有的位置才能執行
(B)未採用裂模法之工作模型，煮聚後無法回復原模
(C)必須重作面弓轉移及重取咬合記錄始可操作
(D)只要以裂模法裝回原咬合器，即可執行
- 29 將蠟型義齒和工作模型包埋於煮聚盒中，可使用之包埋材有：①石膏 ②矽膠 ③瓊膠 ④石英材 ⑤樹脂
(A)①②③ (B)③④⑤ (C)②④⑤ (D)②③⑤
- 30 全口義齒製作時，將樹脂填入煮聚盒中對咬合高度影響最大的方法為何？
(A)美國式包埋加壓法 (B)灌入法
(C)法國式包埋加壓法 (D)以常溫聚合樹脂行流入法
- 31 全口義齒之樹脂以加熱聚合方式製作時，下列敘述何者正確？
(A)一階段法時間較長，但樹脂收縮較大 (B)二階段法時間較短，但單體殘留量大
(C)一階段法時間較長，但樹脂強度較佳 (D)二階段法時間較短，但聚合較完全
- 32 全口義齒煮聚完成後之咬合調整，下述何者優先？
(A)應先裝回咬合器上，進行調整 (B)在口中直接調整修磨
(C)工作側咬合修磨為最優先 (D)須先調成平衡咬合
- 33 利用上顎蠟型義齒包埋前，在重置位架（**remounting jig**）上取得之咬合面石膏齒型，以便假牙重置位之目的為何？
(A)可節省時間與材料 (B)中心咬合位較正確
(C)可減少面弓之誤差 (D)可維持原有上顎與髁頭間之相對關係
- 34 活動義齒之終接線（**finishing line**）是指下列何者？
(A)上顎義齒震動線之最後緣 (B)人工牙齒排列之終止點
(C)下顎義齒臼齒後墊邊緣 (D)樹脂與金屬支架之交界線
- 35 覆蓋式義齒（**overdenture**）是指下列何者？
(A)將所有缺牙部分之支持組織完全覆蓋起來之義齒
(B)將健康之殘留牙根留於齒槽，並加以覆蓋之義齒
(C)在牙床緩壓處經緩壓處理後，再行覆蓋之義齒
(D)腭部手術後，將口鼻間相通之孔洞覆蓋起來之義齒
- 36 全口義齒之上下顎門齒排列時之要求為何？
(A)上下顎牙齒必須在中心咬合位時有接觸
(B)由中心咬合位至前突運動之範圍，上下顎牙齒必須一直保持接觸
(C)只要在下顎前突至切端對切端有上下顎牙齒之接觸即可
(D)必須達到平衡咬合時有持續的上下顎牙齒接觸
- 37 牙齒的排列和發音有極大關係。中文之「膚」音是屬於何種發音？
(A)雙唇音 (B)唇齒音 (C)舌齒音 (D)舌齒槽音

- 38 全口義齒製作時，採用之錫箔代用品，其用途為何？
(A)保護人工牙 (B)石膏分離劑 (C)緩壓使用材 (D)模型加固
- 39 下述有關樹脂之聚合，何者正確？
(A)自聚樹脂比熱樹脂收縮要小
(B)自聚樹脂比熱樹脂之聚合完全
(C)自聚樹脂比熱樹脂之強度較佳
(D)自聚樹脂比熱樹脂之內應力 (internal stress) 較大
- 40 全口義齒之平衡咬合，如在平衡側有咬合干擾時，最優先考慮之修磨處為下列何者？
(A)上顎舌側咬頭之舌面傾斜面 (B)上顎舌側咬頭之頰面傾斜面
(C)下顎頰側咬頭之舌面傾斜面 (D)下顎頰側咬頭之頰面傾斜面
- 41 在活動局部義齒組件中，抵抗義齒以垂直方向脫離牙嵴之組成結構為何？
(A)間接固位體 (indirect retainer) (B)主連接體 (major connector)
(C)直接固位體 (direct retainer) (D)鉤靠 (rest)
- 42 下顎甘迺迪第一類缺牙之患者，口中僅殘留 6 顆前牙，且舌側軟組織具有倒凹現象時，應設計何種主連接體 (major connector) 較為適宜？
(A)舌側槓 (lingual bar) (B)舌側板 (lingual plate)
(C)顎槓 (palatal bar) (D)前後顎槓 (anteroposterior palatal bar)
- 43 下列敘述何者不是使用金屬基底 (metal base) 之優點？
(A)強度高 (B)清潔維護簡便 (C)具美觀性 (D)具較佳之熱傳導性質
- 44 設計義齒基底金屬支架時，宜採用下列何種結構設計，以提供最大的基底樹脂固位作用？
(A)網狀結構 (mesh construction) (B)開放式結構 (open construction)
(C)珠粒式結構 (bead construction) (D)鋼線式結構 (wire construction)
- 45 採用兩部分包埋法 (二層塗刷式) 進行蠟型包埋時，塗刷第一層包埋材料的厚度至少需達多少？
(A)1~2 mm (B)3~4 mm (C)5~6 mm (D)7~8 mm
- 46 在下列何項操作過程中所產生的錯誤，需藉由重置位 (remounting) 的執行加以修正？
(A)灌製工作模型 (model pouring)
(B)析量 (surveying)
(C)以複製材料進行複製 (duplication) 模型
(D)填塞與煮聚壓克力樹脂 (packing and processing)
- 47 進行圍盒 (boxing) 處理時，需將實用蠟 (utility wax) 放置於印模邊緣，並向外延伸多少距離？
(A)1 mm (B)2 mm (C)3~4 mm (D)5~6 mm
- 48 下列何種主連接體 (major connector) 不適合應用於下顎牙齒缺失之活動局部義齒設計中？
(A)舌側板 (lingual plate) (B)舌側槓 (lingual bar)
(C)唇側槓 (labial bar) (D)腭槓 (palatal bar)
- 49 有關電解磨光 (electropolishing) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)需要的電流強度約為 $2A/cm^2$ (B)電解液中所含的主要成分為磷酸
(C)利用切削形式進行支架磨光 (D)是一種去鍍化過程
- 50 以分模式包埋法 (split-mold investing) 進行義齒包埋時，下列何處不可塗佈分離劑？
(A)模型表面 (B)每一層灌注之石膏表面
(C)人工義齒底部 (D)包埋盒之內側面
- 51 複製耐火模型 (refractory cast) 後，須進行表面處理，其主要目的為下列何者？①形成緻密表面
②易於蠟型的製作 ③使模型硬化 ④使模型美觀
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 52 製作活動義齒時，利用包埋材 (investment) 所灌製的模型稱之為何？
(A)耐火模型 (B)診斷模型 (C)工作模型 (D)平行模型

- 53 進行活動局部義齒設計時，連接主連接體（major connector）與鉤靠（rest）組件之部位，稱為下列何者？
(A)直接固位體（direct retainer） (B)小連接體（minor connector）
(C)間接固位體（indirect retainer） (D)終接線（finishing line）
- 54 在無牙嵴區域貼製的緩壓蠟（relief wax）之厚度編號為何？
(A)20~22 號 (B)24~26 號 (C)28~30 號 (D)32~36 號
- 55 直接固位體（direct retainer）的結構組件中，不包含下列何種構造裝置？
(A)鉤靠（rest） (B)小連接體（minor connector）
(C)固位性牙鉤（retentive clasp） (D)模型止位（cast stop）
- 56 下列那一種缺牙情形屬於牙齒支持式活動局部義齒？
(A)甘迺迪第一類（class I） (B)甘迺迪第二類（class II）
(C)甘迺迪第三類（class III） (D)甘迺迪第一類變異 1（class I modification 1）
- 57 下列那一顆支柱牙（abutment）不宜放置咬合鉤靠（occlusal rest）？
(A)上顎小白齒 (B)上顎大白齒 (C)下顎犬齒 (D)下顎大白齒
- 58 製作活動局部義齒時，下列那一種情況的患者適合採用精密附連體（precision attachment）之設計？
(A)口腔衛生不佳者 (B)手部操作能力不良者
(C)具足夠高度與厚度之支柱牙 (D)牙周健康不良之支柱牙
- 59 為能正確記錄並取得上下顎之咬合關係，最不宜選用的是下列何種材料？
(A)快速硬化牙科用硬石膏
(B)氧化鋅丁香油酚（zinc oxide-eugenol）咬合記錄糊劑
(C)蠟
(D)聚乙醚（polyether）咬合記錄膠
- 60 在模型複製過程中，為防止複製材料的變形與撕裂，在主模型上不必要的倒凹處，須進行何種手續？
(A)平行封凹（parallel blockout） (B)成形封凹（shaped blockout）
(C)任意封凹（arbitrary blockout） (D)緩壓（relief）
- 61 若上顎採用腭槓（palatal bar）作為主連接體（major connector）設計時，則其後緣不宜超越何處？
(A)第一小白齒 (B)第二小白齒 (C)第一大白齒 (D)第二大白齒
- 62 製作活動局部義齒時，關於主連接體（major connector）之設計，在選用材料時應以何項性質為主要考量因素？
(A)耐磨性 (B)彈性 (C)抗拉強度 (D)剛硬性
- 63 甘迺迪第四類缺牙患者不宜設計下列何種主連接體（major connector）？
(A)腭槓（palatal bar） (B)馬蹄型（horseshoe）
(C)舌側板（lingual plate） (D)前後腭槓（anteroposterior palatal bar）
- 64 下列何者不屬於 RPI 的組成結構？
(A)近心鉤靠（mesial rest） (B)遠心鄰接面板（distal proximal plate）
(C)近心鄰接面板（mesial proximal plate） (D)I 型槓牙鉤（I-bar clasp）
- 65 下列何者不是常用的鉤靠（rest）型態？
(A)舌側隆凸鉤靠（cingulum rest） (B)切緣鉤靠（incisal rest）
(C)頰側鉤靠（buccal rest） (D)咬合鉤靠（occlusal rest）
- 66 最常作為放置舌側隆凸鉤靠（cingulum rest）的牙齒為下列何者？
(A)上顎正中門齒 (B)上顎犬齒 (C)上顎小白齒 (D)下顎小白齒
- 67 當患者之硬腭區域具有嚴重之骨性隆凸（torus）時，應設計下列何種主連接體（major connector）？
(A)腭槓（palatal bar） (B)前後腭槓（anteroposterior palatal bar）
(C)腭帶（palatal strap） (D)舌側槓（lingual bar）

- 68 在下顎甘迺迪第一類活動局部義齒的遠伸性基底（distal extension denture）中，下列何者可作為垂直壓力的主要承受區？
(A)齒槽嵴頂（alveolar crest） (B)頰棚（buccal shelf）
(C)臼齒後墊（retromolar pad） (D)舌側斜面（lingual incline）
- 69 製作活動局部義齒中採用 I 型槓系統（I-bar system）設計時，其鄰接板（proximal plate）應放置於支柱牙的何處最為適當？
(A)遠心頰側 (B)遠心側 (C)舌側 (D)近心頰側
- 70 下列何者為不須具備剛硬（rigidity）性質之小連接體（minor connector）？
(A)連接牙鉤組件
(B)連接假牙基底
(C)連接間接固位體或輔助鉤靠
(D)連接槓式牙鉤（bar-type clasp）或漸進性鉤臂（approach arm）
- 71 欲製作活動局部義齒支架（framework）時，其最終之設計（final design）應描繪在下列何者？
(A)工作指示書（authorization） (B)主模型（working cast）
(C)診斷模型（study cast） (D)耐火模型（refractory cast）
- 72 製作下顎甘迺迪第二類活動局部義齒支架時，小連接體（minor connector）的設計須延伸至無牙嵴的那一區域？
(A)全部 (B)二分之一處 (C)三分之二處 (D)四分之一處
- 73 為減少食物滲入主連接體與組織之間，同時亦可增加主連接體與組織間的貼合性，主模型須進行下列何種處理？
(A)緩壓（relief） (B)封凹（blockout）
(C)珠狀緣飾（beading） (D)析量（survey）
- 74 複製耐火模型時，常使用之高溫耐火材料是屬於下列那一種鍵結式之包埋材？
(A)矽酸鹽鍵結 (B)磷酸鹽鍵結 (C)硫酸鹽鍵結 (D)硼酸鹽鍵結
- 75 製作活動局部義齒時，利用析量器（surveyor）所獲得的資訊中，下列敘述何者錯誤？
(A)緩壓（relief）的區域 (B)支柱牙上需進行封凹（blockout）的區域
(C)牙齒豐隆最高點（height of contour） (D)支柱牙的引導面（guiding plane）
- 76 在假牙基底的組織面上添加一層新的材料，藉此恢復義齒基底與軟組織間的貼合性，此操作方式稱為何者？
(A)重置位（remounting） (B)換基底（rebasing）
(C)珠狀飾緣（beading） (D)換底墊（relining）
- 77 製作下顎活動局部義齒時，下列那一個區域最常需要進行緩壓（relief）處理？
(A)正中顎縫線 (B)主連接體之下緣 (C)軟硬腭交接處 (D)支柱牙的倒凹區
- 78 有關析量器（surveyor）操作使用之目的，下列敘述何者錯誤？
(A)以碳色筆標示支柱牙的析量線（survey line）
(B)以分析桿（analyzing rod）決定鉤靠（rest）的位置
(C)蠟刀（wax trimmer）用於封凹（blockout）的修整
(D)以倒凹量器（undercut guage）決定牙鉤尖端的位置
- 79 操作析量器（surveyor）時，對石膏模型傾斜的描述應以何種位置為基準？
(A)以操作者自模型前方的觀點 (B)以操作者自模型後方的觀點
(C)以操作者自模型頰側的觀點 (D)以操作者自模型咬合面的觀點
- 80 活動局部義齒進行複製模型時，最常使用的複製材料為下列何者？①瓊膠（agar） ②藻膠材料（alginate） ③矽膠印模材料（silicone rubber base） ④氧化鋅丁香油酚印模劑（zinc oxide-eugenol impression material）
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④